

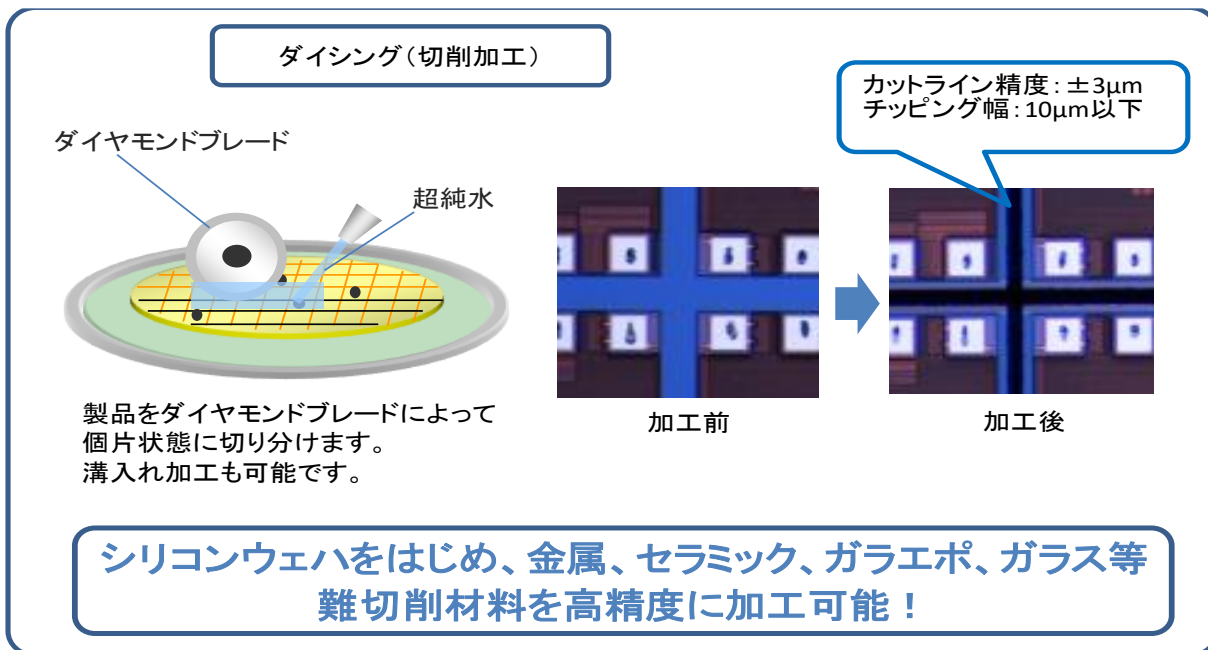
ひとわざ(一技)名: 半導体加工装置を使用した切削加工

1. 概要

シリコンウェハをはじめ、金属、セラミック、ガラエポ、ガラス等の難切削材料の切断受託が可能です。特に、加工精度においては、カットライン精度: $\pm 3 \mu\text{m}$ 、チップング幅: $10 \mu\text{m}$ 以下と高精度の加工が可能です。

切削加工前の裏面研削及び切削加工後のトレイ詰めや、真空梱包等、お客様のニーズに合わせて柔軟に対応致します。

写真・図(要点説明)



2. 企業概況

フリガナ	カブシキガイシャ ニチワコウギョウ	フリガナ	インダ エイスケ
会社名	株式会社 ニチワ工業	代表者名	石田 英祐
		フリガナ	ハマ ケンイチ ・ イトウ ハヤブサ
		窓口担当	浜 健一 ・ 伊藤 隼
事業内容	半導体、難切削材の研削、切削加工	URL	http://www.nichiwak.co.jp
主要製品	精密研削・切削加工、情報画像サプライ品の製造		
フリガナ	ナガノケン チノシ ホンマチヒガシ		
住所	〒391-0003 長野県茅野市本町東3-17		
電話/FAX	0266-72-6840	E-mail	HPから問い合わせください。
資本金(百万円)	15	設立年月	1970年3月
		売上(百万円)	—
		従業員数	125

特記事項(①特許取得・各種認証等取得状況②提供できる価値及び応用分野③SDGsへの取り組み 他

①・JIS Q9001:2025 (ISO9001:2015+Amd1:2024)版取得済み

・JIS Q14001:2025 (ISO14001:2015+Amd1:2024)版取得済み

②半導体用の高精度設備を多数そろえておりますので、上記加工だけでなく、

裏面研削、研磨、レーザーマーキング、ダイシング、各種トレイ詰め、仕様に応じた梱包状態で出荷が可能です。

また、超純水製造設備を所有しておりますので、洗浄作業等も可能です。